

請求の範囲

- [請求項1] 熱可塑性樹脂から形成されている基材層と、
前記基材層の少なくとも一方の面に積層された、樹脂組成物から形成されている表面層と、を有し、且つ、
J I S K 7 1 2 8 - 1 に準拠したトラウザー引裂強度が5 N / m m 以上であり、前記樹脂組成物の剥離力が、J I S Z 0 2 3 7 に従い1 7 5 °Cで測定された場合に、1 5 m N / 3 0 m m 以下であり、前記樹脂組成物の破断点伸度が、J I S K 7 1 2 7 に従い1 7 5 °Cで測定された場合に、7 0 % 以上である、離型フィルム。
- [請求項2] 前記樹脂組成物がフッ素系樹脂である、請求項1 に記載の離型フィルム。
- [請求項3] 前記樹脂組成物がイソシアネート系硬化剤を含む、請求項1 又は2 に記載の離型フィルム。
- [請求項4] 前記樹脂組成物が、四フッ化エチレン樹脂を含む、請求項1 ～3 のいずれか一項に記載の離型フィルム。
- [請求項5] フリップチップ接続される半導体の封止において用いられる、請求項1 ～4 のいずれか一項に記載の離型フィルム。
- [請求項6] 2 回以上の成形のために用いられる請求項1 ～5 のいずれか一項に記載の離型フィルム。